

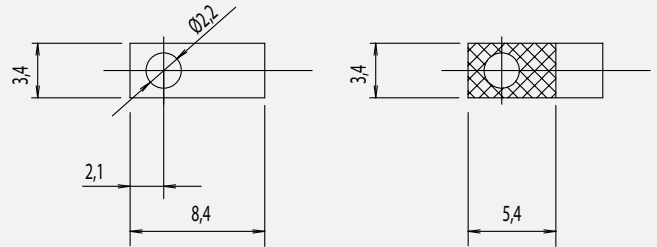
### 1. Produkt | Product



### 2. Leiterplatten Lötbild | PCB layout

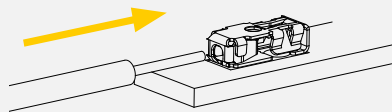
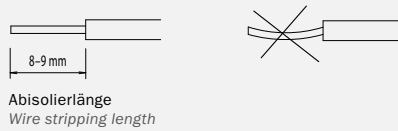
Footprint  
Footprint

Empfohlene Lötpasten-Auftragsfläche /  
Lötpasten-Auftragsstärke: max. 0,12 mm  
Recommended application area for soldering  
paste/stencil thickness: max 0.12 mm



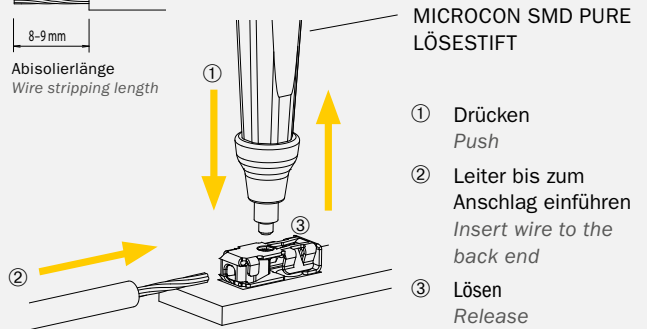
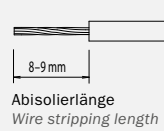
### 3. Leiter einführen (horizontal) | Wire insertion (horizontal)

Eindrähtige Leiter 0,2 – 0,5 mm<sup>2</sup> | Solid wires 0.2 – 0.5 mm<sup>2</sup>

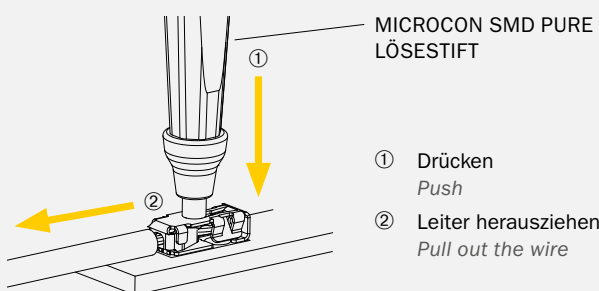


Leiter bis zum Anschlag einführen  
Insert wire to the back end

Flexible Leiter 0,5 mm<sup>2</sup> | Flexible wires 0.5 mm<sup>2</sup>



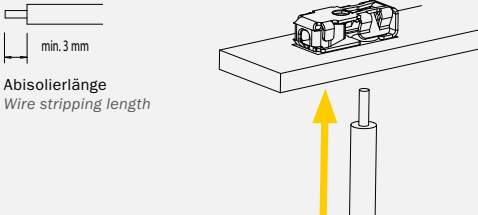
### 4. Leiter lösen (horizontal) | Wire release (horizontal)



Alternative für eindrähtige Leiter: Drehen und Ziehen  
Alternative for solid wires: Twist and pull the wire

**5. Leiter einführen (vertikal)**  
*Wire insertion (vertical)*

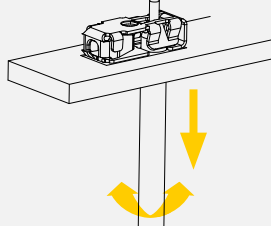
Eindrähtige Leiter 0,5 mm<sup>2</sup> | Solid wires 0.5 mm<sup>2</sup>



Abisolierlänge  
Wire stripping length

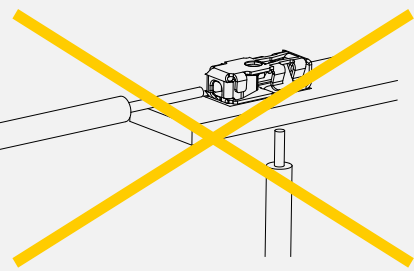
Leiter bis zum Anschlag einführen  
*Insert wire to the back end*

**6. Leiter lösen (vertikal)**  
*Wire release (vertical)*



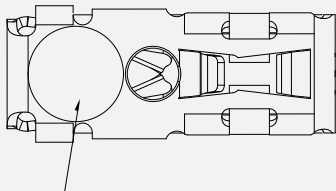
Leiter drehen und Ziehen  
*Twist and pull the wire*

**7. Bitte beachten**  
*Please note*



Entweder horizontalen **oder** vertikalen Anschluss verwenden.  
*Use either horizontal or vertical terminal.*

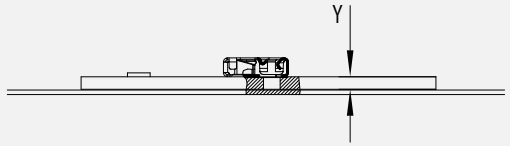
**8. Bestückungs- und Lötinformation**  
*Pick & place and soldering information*



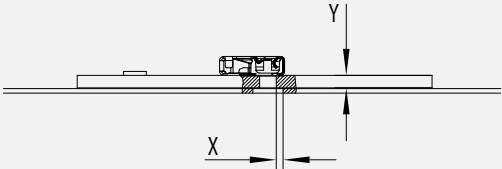
Ansaugfläche Ø 2,5 mm  
*Pick & place area Ø 2.5 mm*

Maximale Löttemperatur / -zeit:  
265 °C / 95 sec.  
*Max. peak soldering temperature / time:  
265 °C / 95 sec.*

**9. Kriech- und Luftstrecken beim Verbau von Leiterplatten mit Loch für das vertikale Stecken beachten**  
*Mind creepage and clearance distances for the mounting of PCBs with hole for vertical connection*



Ausreichende Kriech- und Luftstrecke Y zur Leiterplattenbefestigungsfläche beachten.  
*Please consider sufficient creepage and clearance distance Y between life part and mounting surface.*



Ausreichende Kriech- und Luftstrecke X+Y zur Leiterplattenbefestigungsfläche beachten.  
*Please consider sufficient creepage and clearance distance X+Y between life part and mounting surface.*